

<i>D. Sabbert</i>	Absicherung der EMV zukünftiger Fahrzeuggenerationen – Trends und Strategien	<i>EMC of future cars – trends and strategies</i>	1
<i>D. Peier, T. Weißgerber</i>	Praxisrelevanz des Störfestigkeitsnachweises bei elektronifizierten Bordnetzen	<i>Susceptibility Tests on Electronified Bordnets in Practice</i>	19
<i>M. Krüger, D. Temmen, J. Diezmann</i>	Softwarelösungen für den EMV-Schutz elektronischer Systeme	<i>Solutions for EMC-Protection of electronic systems by software</i>	29
<i>F. Klotz, C. Schulz-Linkholt, T. Steinecke, M. Unger, M. Joester, H. Reindl, S. Reinhardt, C. Roedig, G. Schmid, J. Brückner, W. Pfaff, H. Roozenbeek, A. Rupp</i>	EMV Spezifikation für Halbleiter	<i>EMC Specification for Semiconductors</i>	47
<i>E. Schmidt, R. Maier, H. Pölloth</i>	Trends in der Aufbau- und Verbindungstechnik kontra Anforderungen im Automobil	<i>Trends in the Interconnect Technology versus Requirements in the Car</i>	55
<i>D. Hofmann, J. Melbert</i>	Sicherer Betrieb von parallel geschalteten Leistungstransistoren für Hochstrom-Anwendungen im Kraftfahrzeug	<i>Safe Operation of Parallel Power Transistors for High-Current Automotive Applications</i>	65

W. Neher, W. Senske	Hochtemperaturelektronik im Kraftfahrzeug – Untersuchun- gen der Aufbau- und Verbin- dungstechnik für Anwendun- gen über 125 °C	<i>High temperature electronic in vehicles – Investigations on interconnect technology and substrate materials for operating temperatures above 125 °C</i>	77
M. Brökelmann, H. Hesse, J. Wallaschek	Neue Verfahren zur Qualitätsüberwachung gebondeter Verbindungen	<i>New methods for quality monitoring of electrical interconnections</i>	103
R. Ingenbleek, H. Remmlinger, U. Rühringer	Mechatronik in der Antriebs- und Fahrwerktechnik	<i>Mechatronics in Driveline and Chassis Technology</i>	121
V. Kirchner, H. Feufel	Pb-freie Steuergeräte und Bauelemente	<i>Lead free electronic control units and devices</i>	139
E. Barke	Herausforderung Chipentwurf	<i>Challenges in Chip Design</i>	153
J. Krücken	Hochintegrierte Systeme mit Schwerpunkt Mikro-Controller	<i>Highly Integrated Systems based on Micro-controller Cores</i>	163
W. Mattern, R. Troppmann	Einsatz von digitaler Signal- verarbeitung im Kraftfahr- zeug am Beispiel von Komfortfunktionen wie Fahrer-Assistenz-Systeme und Audioverarbeitung	<i>Digital Signal Processing enables In-Car Comfort Functions like Adaptive Cruise Control and Audio Processing</i>	177
P. Thoma	Erweiterte Spezifikationen mittels SOI-Technologie	<i>Extended specifications with SOI-Technology</i>	191

J. Marek, St. Finkbeiner	Mikromechanische Sensoren – Treiber für neue Systeme im Kraftfahrzeug	<i>Micromechanical Sensors – Driver for new systems in automotive applications</i>	201
H. Reichl	Hetero-Systemintegration – Innovative Technologien für die Systemintegration in der Automobilelektronik	<i>Hetero Systems Integration – Innovative Technologies for System Integration</i>	209
C. Schmidt, J. Kornmayer	Halbleiter-Architekturen für Automobilanwendungen	<i>Architectures of Semiconductor in Automotive Applications</i>	221
G. Reichart, E. Schmidt	Anforderungen an die Elektronik Hardware im Kraftfahrzeug	<i>Future Requirements on Electronic Hardware in Vehicles</i>	235